

# 第十三届 蓝桥杯 EDA 设计与开发项目 国赛

## 第二部分 设计试题 (85 分)

### 试题一 库文件设计 (5 分)

按照图 1 给出的封装设计要求,设计元器件封装,将其命名为 OP-4。设计完成后,导出嘉立创 EDA 封装 efoo 文件,并将其命名为 OP-4. efoo。

设计要求:

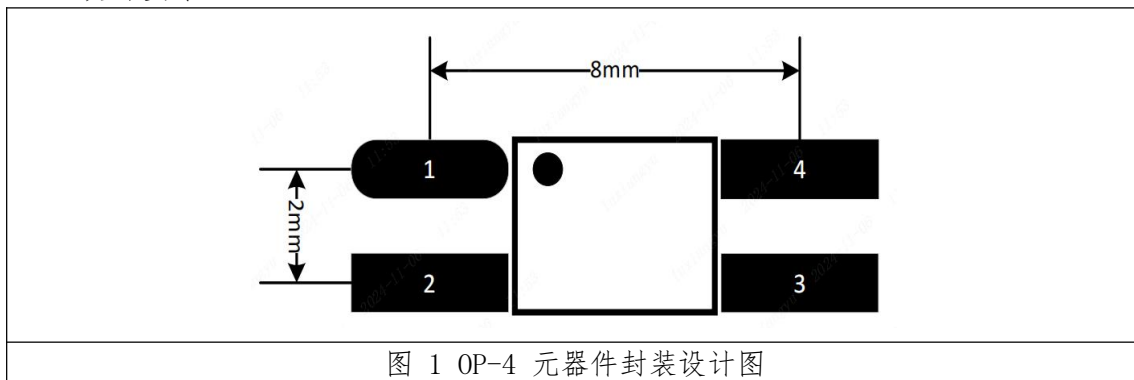


图 1 OP-4 元器件封装设计图

- OP-4 元器件位于顶层。
- 设置 OP-4 引脚 1 为坐标原点。
- OP-4 引脚 1 为长圆形,2、3、4 引脚为矩形。
- 引脚 1-4 焊盘宽、高尺寸: 2mm, 1mm。

### 试题二 原理图设计 (10 分)

使用嘉立创 EDA 专业版设计环境打开“资源数据包”中提供的原理图文件 SCH. epro  
1、数码管驱动电路设计区域内,使用给定的元器件(锁存器-U6、电容等)和网络标识补充完成数码管驱动电路,实现单片机对数码管的显示控制。

设计要求:

- 在原理图中指定的矩形区域内完成电路设计。
- 设计区域内给定的元器件的位号、名称、网络端口名称、网络标识名称等信息不可修改。
- 不可以使用给定元件外的其他元件。
- 完成设计后,需保存原理图文件,并将原理图添加到工程中。

2、完成试题要求的电路设计后,在原理图设计环境下导出嘉立创 EDA 原理图文件和网表文件,分别命名为 SCH. epro 和 1. enet。

### 试题三 印制线路板设计 (70 分)

1、准备工作

- 按照试题一、二中的要求,设计封装、绘制更新原理图文件。

- 打开“资源数据包”中提供的库提取 lib 文件，导入、提取试题相关封装库文件并添加到库中。
- 打开工程文件中的 PCB，更新、同步封装和网络连接关系，开始 PCB 的布局、布线设计。

元器件封装表

序号	位号	封装
1	B1	BAT-SMD_CR1220-2
2	C1,C2	C1206
3	C3,C9,C11,C16, C17, C18, C19,C21,C22,C23,C24,C25, C26	C_C0805
4	C4,C5	C_C0805
5	C6,C10,	C_C0805
6	C7,C8	C1206
7	C12,C13	CAP-D6.3×H5.5
8	C14	C_C0805
9	C15	CAP-D5.0×H5.5
10	C20	C_C0805
11	C53,C54	CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD
12	CN1	CONN-TH_XH2.54-6P
13	CN3	CONN-TH_8P-P2.50-XH2.54-8P
14	D1	SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD
15	D2,D3	DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-DO.5-RD
16	DC1	DC-IN-TH_DC005
17	F1	R_R1210
18	H2	HDR-F-2.54_2X5
19	KEY1	KEY-SMD_4P-L6.0-W6.0-P3.90-LS10.0
20	L1	IND-SMD_L8.3-W8.3
21	LED4	LED-TH_BD3.0_RED
22	M1,M2	CONN-TH_2P-P5.08-WJ500V-5.08-2P
23	R1	R_R0805
24	R2	R_R0805
25	R3	R_R0805
26	R4	R_R0805

27	R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R41	R_R0805
28	R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R24	R_R0805
29	R21, R22, R26, R27,	R_R0805
30	R23, R25, R28, R29, R32, R33, R40, R42	R_R0805
31	R30, R31, R34, R35, R36, R37, R38, R39	R_R0805
32	SEG1, SEG2	LED-SEG-TH_FJ5461AH
33	U1	SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL-E P2.0
34	U2	SOP-16-N
35	U3	SSOP-24_L8.3-W5.6-P0.65-LS7.6-BL
36	U4	SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL
37	U5, U6	SOIC-20_L13.0-W7.6-P1.27-LS10.3-B L
38	U7, U8, U9	OP-4
39	U10	QFP-LQFP-44
40	U11	OP-4
41	U12	SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL
42	U13	OPT0-TH_VS1838B
43	U18	SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR
44	USB1	S_USB-B
45	X2	XTAL-DT38

备注：表中 U7，U8，U9，U11（OP-4）需要选手绘制，其余封装均可以通过库提取方式获得，选手不可以自定义或使用其他封装库。

## 2、元器件布局

在给定的边框层区域内，完成 PCB 的布局设计，不可以修改边框尺寸、形状、画布原点。

- 数码管 SEG1：坐标位置（X=34mm，Y=80mm），旋转角度 0°。
- 数码管 SEG2：坐标位置（X=85mm，Y=80mm），旋转角度 0°。
- 电机 M1 接口：坐标位置（X=114mm，Y=57mm），旋转角度 90°。
- 电机 M2 接口：坐标位置（X=114mm，Y=44mm），旋转角度 90°。

## 通用要求

合理安排布局，元器件之间应相互平行或者垂直排列，以求整齐、美观，不允许元件重叠；元件排列要紧凑，元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。所有元器件均放置在顶层。

## 3、布线设计

在给定的边框层区域内，完成 PCB 的布线设计，不可以修改边框尺寸、形状、画布原点、安装孔相对位置等。

## PCB 设计要求

布线层数：2

字符层：顶层丝印层，文本线宽 6mil，高 45mil，要求摆放整齐，使用设计环境默认字体。

覆铜层：顶层、底层，GND 网络。

网络布通率：100%

4、DRC 规则

线宽：12mil

间距：10mil

孔外径：24mil

孔内径：12mil

文件提交要求

1、将 OP-4. efoo、SCH. epro、PCB. epro 和 1. enet 共 4 个文件，打包为压缩文件(zip 或 rar 文件)，压缩文件以准考证号命名，提交文件。

备注：请确保所有导出文件为最终版本。

2、未按照试题要求命名和提交文件的选手将被酌情扣分或记零分。

3、提交不属于试题要求文件的选手将被酌情扣分或记零分。